

LEDデバイス用シリコン材料①

Silicone materials for LEDs

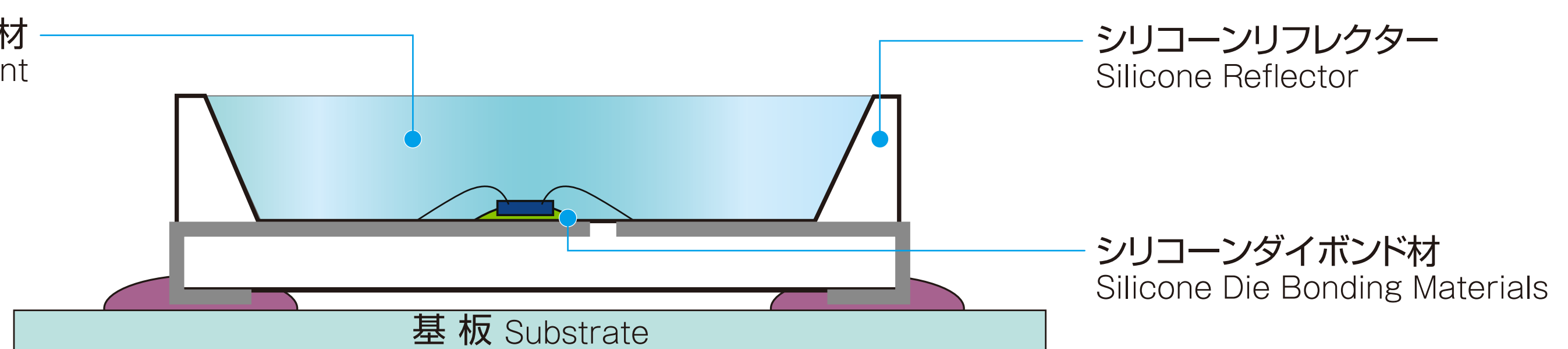
【封止材】Encapsulant Material

品名 Product name	屈折率 Refractive index	硬度 Hardness	製品特徴 Product Characteristics
SCR-1021 A/B	1.52	Shore.D-70	高硬度、高接着タイプ、低ガス透過性 High Hardness.High adhesive.Gas Barrier
ASP-1060 A/B	1.57	Shore.D-43	高屈折率・高硬度、低ガス透過性 High RI, High Hardness, Gas Barrier
ASP-1050P A/B	1.54	Dur.A-66	対クラック性、低ガス透過性 Anti - Crack, Gas Barrier
KER-7060 A/B	1.39	Dur.A-60	低屈折率・高硬度ゴムタイプ、低ガス透過性 Low RI, Hard Rubber, Gas Barrier
KER-7030 A/B	1.39	Dur.A-30	低屈折率・低硬度ゴムタイプ Low RI, Soft Rubber
KER-6110 A/B	1.53	Shore.D-38	高硬度ゴムタイプ、成型可能 Hard Rubber, Good for molding
KER-2460/CAT	1.41	Shore.D-30	高硬度ゴムタイプ、高耐熱・耐変色性、成型可能 Hard Rubber, Good for molding
KER-2500N A/B	1.41	Dur.A-70	中硬度ゴムタイプ、高耐熱・耐変色性、成型可能 Middle hardness rubber, Good for molding
KER-2900 A/B	1.41	Dur.A-19	低硬度ゴムタイプ、高耐熱・耐変色性 Low hardness rubber, High heat resistance
KER-6020 A/B	1.44	Dur.A-15	低硬度ゴムタイプ、高耐熱・耐変色性 Low hardness rubber, High heat resistance
S-Barrier-01	—	—	銀メッキ保護用コーティング材 Silver protective coating material

【使用箇所】

Applications

シリコン封止材
Silicone Encapsulant



【ダイボンド材】Silicone Die Bonding Materials

品名 Product name	ワンポイント One point
KER-3000-M2	シリコンダイボンド材 (標準タイプ) Silicone Die Bonding Materials
KER-3100-U2	白色反射タイプ Reflective Type
KER-3200-T5	白色反射・熱伝導(放熱)タイプ Low thermal resistance
SMP-2800	導電性ポリイミドシリコン Electric Conductivity

【ダム材 (ディスペンス)】Dam Material (Dispensable)

KER-2020DAM

色 Color	白 White
粘度 Viscosity	ペースト Paste
硬化条件 Curing condition = 120°C×1h	
硬さ Hardness	Dur.A 61
伸び Elongation [%]	120
引っ張り強さ Tensile Strength	% 5.7
引っ張り強さ (対エポキシ基板) Tensile Strength (Epoxy Substrate)	MPa 1.2

(規格値ではありません Not specified values)

